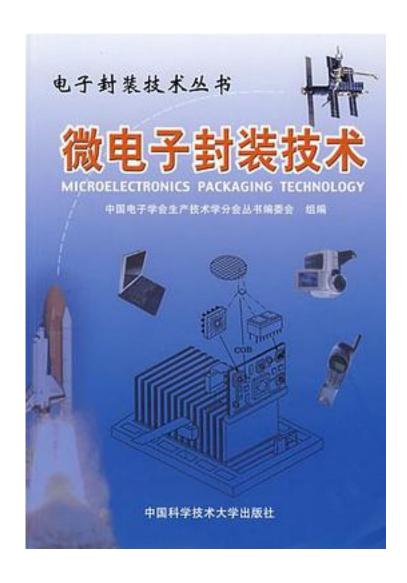
## 微电子封装技术



## 微电子封装技术\_下载链接1\_

著者:中国电子学会生产技术学分会丛书编委会编

出版者:中国科学技术大学出版社

出版时间:2003-4

装帧:

isbn:9787312014253

《微电子封装技术(修订版)》比较全面、系统、深入地论述了在晶体管和集成电路(IC

)发展的不同历史时期出现的典型微电子封装技术,着重论述了当前应用广泛的先进IC 封装技术-QFP、BGA、CSP、FCB、MCM和3D封装技术,并指出了微电子封装技术今后的发展趋势。全书共分8章,内容包括:绪论;芯片互连技术;插装元器件的封装技术;表面安装元器件的封装技术;BGA和CSP的封装技术;多芯片组件(MCM);微电子封装的基板材料、介质材料、金属材料及基板制作技术;未来封装技术展望。书后还附有微电子封装技术所涉及的有关缩略语的中英文对照等,以便读者查阅。《微电子封装技术(修订版)》涉及的知识面广,又颇具实用性,适合于从事微电子封装研发、生产的科技人员及从事SMT的业界人士阅读,也是高校相关专业师生的一本有价值的参考书。
作者介绍:
目录:
微电子封装技术_下载链接1_
标签

微电子封装

评论

书评

微电子封装技术\_下载链接1\_

微电子封装技术\_下载链接1\_